技术指标及商务要求响应表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明(无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| 隔震地基项目 | 1 | 地基尺寸要求 | 长\*宽\*高：7840mm\*3175mm\*2980mm |  |  |
| 2 | 地基防震等级 | 满足VC-B等级 |  |  |
| 3 | 地基表面水平度 | 水平度±2mm之内(每平方米) |  |  |
| 4 | 地基承重要能支撑机台 | 机台总重≥27吨 |  |  |
| 5 | 其他 | 乙方施工时不能破坏下层已有的厂务线路或管道；地基施工完成后上层地板的包边工作由乙方负责 |  |  |
| 6 | 资质 | 营业执照、机电工程施工总承包三级及以上资质、钢结构工程专业承包三级及以上资质 |  |  |
| 7 | 付款条件 | 预付30%，验收合格后30日内支付尾款 |  |  |
| 8 | 服务 | 含装卸、吊装搬运、安装服务 |  |  |
| 9 | 业绩 | 至少2个半导体或面板行业同类业绩 |  |  |

 公司名称（盖章）：

 日期：